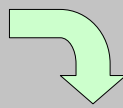


Multilayer Components

FDKは、独自の素材技術・シミュレーション技術・高周波回路技術をベースに、高周波回路・高周波モジュール用「積層チップインダクタ AMLシリーズ」「RFコンポーネント AMB / AMS / ALP / ABPシリーズ」を提供しております。第3～4世代携帯機器、モバイル機器用RFモジュールなどの小型設計に最適なチップを提供すべく、多彩なラインナップを取り揃えています。

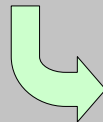
Basic Technologies

1. Material
2. Fine patterning/ laminating
3. CAE by super computer
4. High frequency circuit



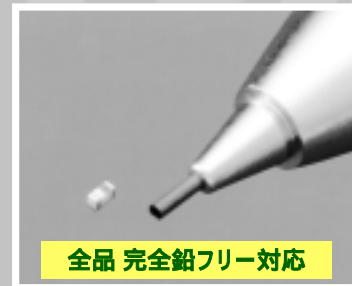
Main Products

Inductor(1005,0603)
Multilayer BPF



RF-components

Balun(2015,1608)
Coupler(2012,1608)
LPF(1005),BPF(2012)



全品 完全鉛フリー対応

Lineup of Chip Inductor (AML series)

Type	Size	Q range (1GHz)	L range (nH)			
	(mm)		1	10	100	1000
AML1005H	1.0 × 0.5	19 – 35	1-100			
AML1005S		>25	120-220			
AML1005Q		<40	1-18			
AML0603Q	0.6 × 0.3	17 – 21	1-22(-56)			

Wide Inductance and High Q of 1005 and 0603 type

Lineup of RF-Components

	Type	Size	Frequency (GHz)				
		(mm)	1	2	3	4	5
Balun	AMB2012	2.0 × 1.25	1-5				
	AMB1608	1.6 × 0.8	Under development				
Coupler	AMS2012	2.0 × 1.25	1-5				
	AMS1608	1.6 × 0.8	Under development				
Low Pass Filter	ALP1005	1.0 × 0.5	1-5				
Band Pass Filter	ABP2520	2.5 × 2.0	Under development				

当カタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することや、製造を中止する事があります。ご注文に際しては弊社営業担当部門にご確認ください。